

软件技术与数据库

软件维护外包后的缺陷修正流程改进及分析

李玉鹏, 侯红

(西北大学软件工程研究所, 西安 710127)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 2007-5-17 接受日期

摘要

通过研究某公司的大型芯片测试软件维护(纠错性维护和完善性维护)跨国外包后的缺陷修正方法, 总结得到了缺陷修正的基本控制流程。针对基本控制流程的缺点, 从降低维护成本和提高缺陷修正的效率等方面出发, 提出了一系列改进方案及新的缺陷修正流程, 给出了流程改进后的软件质量保证和项目组的工作效率分析。

关键词 [软件外包](#) [缺陷修正](#) [缺陷修正流程](#) [流程改进分析](#)

分类号 [TP311](#)

DOI:

通讯作者:

作者个人主页: [李玉鹏](#); [侯红](#)

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#)(97KB)

▶ [\[HTML全文\]](#)(0KB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“软件外包”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [李玉鹏, 侯红](#)